

# 苏州国芯科技股份有限公司

## 2024年7月11日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2024-012

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中欧基金；中信证券；兴业证券；人保资产；建信保险资管；大都会人寿保险；工银安盛保险；中原农险；招银理财；万丰友邦投资；中韩人寿；兴业理财；长江养老保险；南银理财；太平资产；交银保险。
时间	2024年7月11日 10:00
地点	公司会议室
上市公司参加人员姓名	董事长：郑荭先生 董事会秘书：黄涛先生 证券事务代表：龚小刚先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题和内容，本表不再重复记录，更多关于公司的情况敬请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的定期报告和临时报告。除重复问题及内容外，投资者本次提问的问题主要如下：</p> <p>1、请问公司汽车电子芯片业务的发展战略是什么？</p> <p>答：公司正在大力发展汽车电子芯片业务，在研发、市场上都进行了重点投入，近年来已经取得长足进展，公司在汽车电子芯片业务上坚持“顶天立地”和“铺天盖地”的发展战略，持续推进国产替代。</p>

所谓“顶天立地”，是指公司将瞄准目前尚被国际大公司垄断的芯片产品，组织资源全力开发，重点填补国内在汽车电子领域的重要的开发难度大而又尚属鲜有国产化的产品。如公司开发的安全气囊点火驱动芯片、加速度传感器芯片和高集成门驱芯片，由于技术难度大、可靠性要求极高等原因，技术和市场长期被国外厂商垄断。公司目前已推出安全气囊点火芯片 CCL1600B+MCU 主芯片+加速度传感器 CMA2100B 的全自主方案，有望形成公司新的优势竞争力。

所谓“铺天盖地”，是指公司积极对标国际大公司，对汽车 MCU 上主要的芯片产品进行广泛布局，努力实现产品线的全系列化和全覆盖，建立起丰富的 MCU 芯片产品群。汽车电子芯片厂商的竞争是全系列产品的竞争，只有一两款芯片产品是无法和国外公司展开有效竞争的。公司为抓住汽车芯片国产化替代的历史机遇，加大力气投入研发，迅速扩展公司汽车电子 MCU 芯片产品群，目前产品线包括汽车车身和网关控制芯片、动力总成控制芯片、域控制芯片、新能源电池管理芯片、车联网安全芯片、数模混合信号类芯片、主动降噪专用 DSP 芯片、线控底盘芯片、仪表及小节点控制芯片、安全气囊芯片、辅助驾驶处理芯片和智能传感芯片等 12 条产品线，产品丰富度极大提升。

公司未来仍将坚持“顶天立地”和“铺天盖地”的发展战略不动摇，持续保持战略定力，既要持续打造公司在高端汽车电子 MCU 芯片产品领域的优势，又要积极丰富汽车电子 MCU 芯片产品的品类，推进资源优化和聚焦，注重产品技术平台化，发挥后来者居上和本地化优质服务的优势，积极解决客户使用芯片产品存在的痛点问题，用技术和服务赢得更广阔的市场空间，为国产汽车电子 MCU 芯片的突破做出应有的贡献。

**2、请介绍一下公司在汽车电子领域所强调的“MCU+”策略？请问公司在产业生态建设和合作伙伴构建上做了哪些工作？**

答：公司坚持从客户中来到客户中去，紧密结合客户的迫切需

要，针对公司汽车电子 MCU 产品系列，与客户密切合作，积极发展与 MCU 芯片有重要联动的其他汽车电子芯片，持续推出了系列化的套片方案，满足了客户的需要。公司可向客户提供“MCU+”选项，即以 MCU、混合信号（含驱动类）和通信接口芯片的整体方案来解决客户的“套片”方案式需求，增进与客户合作的广度、深度和粘性，与客户展开更加全面的合作。公司投入了较大力量相继开发出安全气囊点火专用芯片 CCL1600B、PSI5 收发器 CIP4100B、智能传感芯片 CMA2100B 等多种类车规级芯片产品，并面向车门、窗、后视镜的执行器使用开发汽车门区驱动芯片 CCL1100B。

上述安全气囊点火专用芯片、传感器芯片、数模混合专用驱动类芯片等产品的研发进一步丰富了公司的汽车电子产品线，有助于公司从 MCU 系列产品线拓宽到模数混合专用芯片领域，满足了客户的需求。通过“MCU+”的策略，公司可以为客户提供更加完善亦更有成本竞争力的方案，从而进一步提升公司汽车电子 MCU 芯片的整体竞争力，促进了公司产品的市场开拓。

此外，公司持续加强产业生态建设，十分重视加强与产业链内合作伙伴的合作，希望聚集各方资源把公司的业务做大做强，公司在今年上半年以来持续和汽车电子芯片领域合作伙伴合作，积极聚焦和整合资源，充分发挥各方优势，具体如下：

（1）与普华基础软件股份有限公司签署战略合作框架协议，加速打造汽车电子 MCU 芯片及控制器基础软件的国产软硬件解决方案；

（2）与北京英创汇智科技有限公司达成战略合作，致力于共同推进新能源汽车线控底盘产品技术提升和国产化。英创汇智上半年已研发成功的 100% 国产器件的汽车制动安全系统系列产品 ABS/ESC/EPBi 使用了公司的汽车电子 MCU。目前，英创汇智的基于 CCFC3007PC 芯片的 One-Box 解决方案已进入开发阶段，正在加速推进，预计将于 2025 年第一季度实现 SOP；其采用 CCFC2016BC 的 EPBi

和 ESC 已完成车辆实地测试,很快将进入量产阶段;搭载 CCFC2012BC 芯片的 ABS 也即将正式进入量产阶段;

(3) 与东软睿驰汽车技术(上海)有限公司达成战略合作,共同研发基于公司芯片与东软睿驰 NeuSAR 适配的解决方案,致力于打造“中国芯+中国软”的领先技术;

(4) 与上海汽车芯片工程中心有限公司达成战略合作,将在汽车芯片设计、系统集成及应用、芯片测试分析、芯片生产与制造等领域进行深入合作;

(5) 与上海同驭汽车科技有限公司达成战略合作,共同合作打造汽车电子线控底盘控制器国产化解决方案;

(6) 与深圳飞音科技有限公司签署合作协议,双方将联合研发和推广基于 CCD5001 和 CCD4001 芯片的车载功放产品解决方案。目前,CCD5001 和 CCD4001 芯片已经向客户提供工程样品,国内多家 Tier1 厂商在测试评估中,已有 Tier1 客户获得主机厂定点,启动基于 CCD5001 芯片的音频项目开发。

此外,业界知名的美国 DSP Concepts 公司通用音频开发平台 AudioWeaver 已经完成 CCD5001 适配并提供给客户使用。华研慧声正在基于 CCD5001 开发车载主动降噪方案,将于三季度完成。国芯科技正在联合业界头部音频算法供应商基于 CCD5001 开展 3D 环绕音效、RNC/ENC 主动降噪、主动声设计、杜比音效等开发工作;

(7) 与智新控制系统有限公司签署战略合作框架协议,智新控制将在 VCU、BMS 等多个关键项目上优先使用公司的 CCFC2010BC 和 CCFC2012BC 芯片,在高端 VCU、BMS、电机控制和 TCU 项目上将使用公司的高性能多核 MCU CCFC3008PT 和 CCFC3007PT;

(8) 与武汉菱电汽车电控系统股份有限公司签署战略合作框架协议,菱电电控将在发动机控制器、新能源整车控制器、电机控制器、域控制器等多个关键项目上优先使用公司的系列芯片;

(9) 2024 年上半年,江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公

司与公司在发动机控制领域的重要合作项目顺利装车，奥易克斯的动力总成项目中首次选用了公司的 CCFC2017BC，并将在下一代高性能缸内直喷发动机项目中选用公司的高性能、多核、满足 ASIL-D 的 CCFC3007PT 芯片。

**3、目前公司汽车电子芯片业务的市场与主要客户情况怎么样？**

答：公司重点发展中高端汽车电子芯片业务，公司的汽车电子芯片产品已经进入了比亚迪、奇瑞、吉利、上汽、上汽通用、上汽通用五菱、长安、长城、一汽、东风、小鹏等众多汽车整机厂商，在数十款自主及合资品牌汽车上实现批量应用。公司在传统的车身控制及动力总成应用之外，已拓展线控底盘、域控、安全气囊和车联网信息安全等领域的重要客户，并取得了 100+个项目定点开发。

公司与国内国际知名的 Tier1 模组厂商保持了紧密合作，包括埃泰克、经纬恒润、科世达（上海）、弗迪科技、长江汽车电子、欧菲智能、易鼎丰、英创汇智、安波福、采埃孚等，公司的汽车电子芯片产品持续被 Tier1 模组厂商定点开发或批量采用。

随着汽车电子芯片去库存进入尾声阶段，我们看到目前汽车电子芯片的需求正在逐步恢复，同时随着定点开发项目的推进，我们会有更多的中高端芯片实现量产。

**4、请问公司在汽车电子芯片领域的核心竞争力是什么？**

答：在长期发展的过程中，公司在汽车电子领域形成了较为深厚的技术、平台、客户资源的积累，构成了公司开拓汽车电子芯片业务的核心竞争力。主要包括：

（1）公司的汽车电子 MCU 芯片主要采用公司自主可控的 PowerPC 架构和 RISC-V 架构 CPU 核进行开发，无须支付授权费（License Fee）和版税（Royalty），性价比高。更为重要的是，公司全面掌握了嵌入式 CPU 的微架构自主设计技术，可根据客户需求进行微架构调整，使芯片产品更贴合客户的实际应用；

(2) 公司已建成汽车电子和工业控制 SoC 芯片设计平台, 该平台采用 32 位高可靠的 PowerPC 架构和 RISC-V 架构的处理器, 基于汽车电子工艺设计, 公司可基于该平台进行汽车电子芯片的快速迭代开发;

(3) 公司从 2010 年开始研发汽车电子芯片, 至今已有 10 多年的历史, 已有数十款汽车电子芯片的成功设计开发经验, 对于产品质量的把控具有丰富的经验, 赢得了客户的广泛信赖;

(4) 公司与行业内诸多大客户构建了“紧耦合”的合作关系。公司汽车电子芯片的新产品研发奉行“从客户中来, 再到客户中去”的高效运行法则。所谓“从客户中来”就是每一款产品的定义都是来自于主要目标客户, 根据客户的需求而提出, “再到客户中去”就是在产品研发过程中的不同阶段, 芯片设计的规格、性能、指标要满足客户所需, 要服务于客户, 要解决客户遇到的问题和痛点;

(5) 公司建立了一支技术实力强、服务专业的汽车电子技术支持团队, 公司可以为客户提供本地化、全天候的技术支持服务, 可以协同客户一起迅速解决各种问题, 推进芯片产品的快速开发和使用。

##### **5、公司的高端域控芯片业务的进展情况怎么样?**

答: 公司在汽车高端域控制芯片领域布局了 CCFC3007XX、CCFC3008 XX 和 CCFC3012 XX、CCFC3009 XX 系列 MCU 芯片产品群, 目前部分相关芯片产品已经实现装车应用。

CCFC3008PC/PT 和 CCFC3007BC/PT 系列芯片按照汽车电子 Grade1 等级、信息安全 Evita-Full 等级、功能安全 ASIL-D 等级进行设计和生产, 具备高可靠性和高安全性, 可以同时适用于汽车电子动力总成、底盘控制器、动力电池控制器以及高集成度域控制器等应用场景。CCFC3007XX 系列可以对标英飞凌 TC367 系列以及 NXP 的 MPC5777x 系列。公司根据客户需求开发了 CCFC3007BC, 这是 CCFC3007PT 的简化版本, 主要用于客户车身域控制器的低成本方案。

	<p>自推出市场后，CCFC3007PT 和 CCFC3008PT 系列芯片已获得多家头部汽车主机和零部件厂商的定点开发。CCFC3008PT 已于 2024 年 1 月获得 50 万颗的订单。CCFC3007PT 目前亦已在多家重点客户域控应用实现定点开发。</p> <p>公司正在流片的 CCFC3012PT 是专为智能驾驶和新一代域控系统设计的芯片，搭载自研 C3007 CPU 核，采用多核 PowerPC 架构（6 主核+4 锁步核），算力高达 2700DMIPS 以上，并融合功能安全与信息安全处理功能。CCFC3012PT 在算力、存储及接口性能等方面均达到国际同类产品的先进水平，与国际知名厂商英飞凌的 TC397 芯片性能相当。</p> <p>正在设计中的 CCFC3009PT 则是公司首款基于 RISC-V CPU 的高性能车规 MCU 芯片，采用高性能 RISC-V 架构（5 个主核+3 个锁步核），预计算力更高可达到 6000DMIPS 以上，将具有行业先进水平。CCFC3009PT 设计指标将可与英飞凌最新的 TC4XX 系列芯片进行对标。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 7 月